

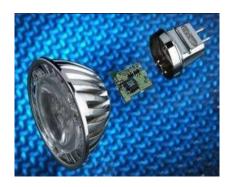
# 无硅导热膏

## 【产品概述】

AG560-50 无硅导热膏是一种导热界面材料的非硅膏状化合物,不易变干;它可以把热能从发热设备引导至散热片和底盘上.该产品在导热金属氧化物被填充的情况下依然能够绝缘导热.AG560-50有低渗透性,良好的耐温性和低流动性的特点,无硅烷小分子挥发,不会产生碳化硅引起电路不良。

### 【产品图示】





特性参数 AG560-50		
产品性能	测试结果	测试标准
颜色	灰色	目视
粘度 25℃	300K cps	Brookfield RVF,#7
密度 g/cm³	2. 8	***
使用温度 <sup>°</sup> F/ <sup>°</sup> C	-45 to 130°C	***
导热率 W/mK	5. 0	ASTM D5470
热阻 (°C-in²/W)@50psi	0. 07	ASTM D5470
RoHS	PASS	IEC 62321
Ha l ogen	PASS	EN14582
REACH	PASS	EN14372

使用 ASTM D5470 测试夹具。记录值包括界面热阻。这些数值仅供参考。实际应用性能直接关系到所施加的表面粗糙度、平整度和压力。

#### 【特点与优势】

- 导热率 5.0W/mK
- 耐干枯
- 符合 RoHS 要求
- 无硅氧烷挥发
- 无需预热
- 适用于自动配料及丝网 印刷等生产工艺

#### 【典型应用】

- 高频微处理器、手机
- 笔记本和台式电脑
- 计算机
- 电源适配器
- 音频视频设备
- LED 照明产品

【储存&运输】 贮存于通风、阴凉、干燥处,不要接触明火。本产品无毒,按非危险品贮存及运输。

【包 装】 根据客户需求定制包装 【**有效期**】 本产品有效期为 24 个月

【安 全】 请参阅本公司《材料安全性能数据(MSDS)》

以上这些建议及数据均来自我们认为可靠的资料。虽然是以诚信提供,但由于我们无法控制产品的使用条件和方法,无法对兼容性的应用提出任何建议, 因此这些建议及数据仅供参考,而不作为产品保证。在任何时候,应由用户最终决定他们的生产线是否能够有效地使用。应由买方决定产品是否合适或适用 特殊用途。不保证产品质量或适用性可满足任何特殊用途。我们建议潜在用户在大量使用前,首先确定我们的材料适用性和建议。